(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-164186 (P2001-164186A)

(43)公開日 平成13年6月19日(2001.6.19)

(51) Int.Cl.'	識別配号	FΙ	テーマコード(参考)		
C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4 វ 0 3 ដ		
C 0 8 G '77/08		C 0 8 G 77/08	4 J 0 3 8		
C 0 9 D 183/02		C 0 9 D 183/02	5 F 0 5 8		
183/14		183/14	•		
H01L 21/312		H01L 21/312	С		
		審査請求 未請求 請求	項の数10 OL (全 14 頁)		

(21)出願番号 特願2000-220271(P2000-220271) (71)出願人 000004178 ジェイエスアール株式会社 (22) 出顧日 平成12年7月21日(2000.7.21) 東京都中央区築地2丁目11番24号 (72)発明者 黒澤 孝彦 (31) 優先権主張番号 特願平11-275553 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ (32)優先日 平成11年9月29日(1999.9.29) エスアール株式会社内 (33)優先権主張国 日本 (JP) (72)発明者 林 英治 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 (74)代理人 100085224 弁理士 白井 重隆

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物、膜の形成方法および絶縁膜

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜として有用な、低誘電率、高弾性率の膜が得られるポリオルガノシロキサン系の膜形成用組成物を提供する。

【解決手段】 (A)、下記一般式(1)、(2)、

(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種をアルカリ金属触媒の存在下に加水分解し、縮合した縮合物と、(B)下記一般式(1)、(2)、(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種を酸触媒の存在下に加水分解し、縮合した縮合物、とを含有する膜形成組成物。

 R_{a} (Si) (OR 1) $_{4\text{-}a}$ (1)

Si (OR²)₄······(2)

 R^{3}_{b} (R^{4} O)_{3-b} Si - (R^{7})_d - Si (O

 R^5)_{3-c} R^6 _c ... (3)

(式中Rは水素原子、フッ素原子、又は一価の有機基、R 1 \sim R 6 は一価の有機基、R 7 は酸素原子、フェニレン基又は $^-$ (CH $_2$) $_n$ $^-$ 、aは $1\sim$ 2の整数、b、cは $0\sim$ 2の数、dは0または1、nは $1\sim$ 6の整数を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される化合 物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一般 式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも 1種のシラン化合物をアルカリ触媒の存在下に加水分解 し、縮合した加水分解縮合物、ならびに(B)下記一般 式(1)で表される化合物、下記一般式(2)で表され る化合物および下記一般式(3)で表される化合物の群

$$R^3$$
 b $(R^4$ O) $_{3-b}$ S $i-(R^7)$ d $-S$ i (OR^5) $_{3-c}$ R^6 c

 $[式中、<math>R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ 1 価 の有機基、b~cは同一または異なり、0~2の整数、 R^7 は酸素原子、フェニレン基または $-(CH_2)_n$ – で表される基(ここで、nは1~6の整数である)、d は0または1を示す。)

【請求項2】 (A) 成分の加水分解縮合物のGPC法 による重量平均分子量が5万~1,000万である請求 項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 (B)成分の加水分解縮合物のGPC法 による重量平均分子量が500~30万である請求項1 記載の膜形成用組成物。

【請求項4】 (A)成分が一般式(2)で表される化 合物の加水分解縮合物(完全加水分解縮合物換算)を5 ~75重量%含有する請求項1~3いずれか1項記載の 膜形成用組成物。

【請求項5】 (A)成分が一般式(1)で表される化 合物および一般式(2)で表される化合物からなるシラ ン化合物の加水分解縮合物である請求項1~4いずれか 1項記載の膜形成用組成物。

【請求項6】 (A)成分(完全加水分解縮合物換算) 100重量部に対し、(B)成分(完全加水分解縮合物) 換算)を1~900重量部含有する請求項1~5いずれ か1項記載の膜形成用組成物。

【請求項7】 pHが7以下である請求項1~6いずれ か1項記載の膜形成用組成物。

【請求項8】 請求項1~7いずれか1項記載の膜形成 用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜 の形成方法。

【請求項9】 請求項8記載の膜の形成方法によって得 られる絶縁膜。

【請求項10】 請求項9記載の絶縁膜を有する半導体 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリオルガノシロ キサン系の膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半 導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、低比誘電 率、かつ高弾性率を有する膜が形成可能なポリオルガノ シロキサン系の膜形成用組成物に関する。

[0002]

から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を酸触媒の 存在下に加水分解し、縮合した加水分解縮合物を含有す ることを特徴とする膜形成用組成物。

 $R_a Si (OR^1)_{4-a} \cdots (1)$ (式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si (OR²)₄ (2) (式中、R² は1価の有機基を示す。)

 \cdots (3)

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ(SiO。)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間 絶縁膜が開発されている。しかしながら、現在、知られ ている有機SOGの比誘電率は、3~4程度であり、そ れより優れた低比誘電率を有し、かつ充分な機械的強度 を有するものは知られていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用の組成物に関し、さらに詳し くは、例えば半導体素子などにおける層間絶縁膜とし て、低比誘電率で、かつ高弾性率の硬化膜を形成するこ とが可能なポリオルガノシロキサン系の膜形成用組成物 を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一 般式(1)で表される化合物(以下「化合物(1)」と もいう)、下記一般式(2)で表される化合物(以下 「化合物(2)」ともいう)および下記一般式(3)で 表される化合物(以下「化合物(3)」ともいう)の群 から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物をアルカリ 触媒の存在下に加水分解し、縮合した加水分解縮合物 (以下「(A)加水分解縮合物」ともいう)、ならびに (B) 化合物(1)、化合物(2) および化合物(3) の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を酸触 媒の存在下に加水分解し、縮合した加水分解縮合物(以 下「(B)加水分解縮合物」ともいう)を含有すること を特徴とする膜形成用組成物に関する。

 $R_a Si (OR^1)_{4-a} \cdots (1)$ (式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) $Si(OR^2)_4 \cdots (2)$ (式中、R² は1価の有機基を示す。)

 R^{3}_{b} (R^{4} O)_{3-b} Si - (R^{7})_d -Si (OR⁵)_{3-c} R^{6}_{c} · · · · · (3)

〔式中、 $R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ 1 価の有機基、 $b \sim c$ は同一または異なり、 $0 \sim 2$ の整数、 R^7 は酸素原子、フェニレン基または $-(CH_2)_n$ - で表される基(ここで、nは $1 \sim 6$ の整数である)、dは 0 または 1 を示す。〕

ここで、(A)加水分解縮合物のGPC法による重量平 均分子量は、5万~1,000万であることが好まし い。また、(B)成分の加水分解縮合物のGPC法によ る重量平均分子量は、500~30万であることが好ま しい。さらに、上記(A)成分は、一般式(2)で表さ れる化合物の加水分解縮合物(完全加水分解縮合物換 算)を25~75重量%含有することが好ましい。さら に、上記(A)成分は、一般式(1)で表される化合物 および一般式(2)で表される化合物からなるシラン化 合物の加水分解縮合物であることが好ましい。また、上 記(A)成分と(B)成分の割合は、(A)成分(完全 加水分解縮合物換算)100重量部に対し、(B)成分 (完全加水分解縮合物換算)が1~900重量部が好ま しい。さらに、本発明の膜形成用組成物のpHは、7以 下であることが好ましい。次に、本発明は、上記膜形成 用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜 の形成方法に関する。ここで、上記膜の形成方法によっ て得られる膜の用途としては、絶縁膜が好ましい。次 に、本発明は、上記絶縁膜を有する半導体装置に関す る。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明は、膜を形成するベースポ リマーとして、(A)成分(化合物(1), (2)およ び(3)の群から選ばれた少なくとも1種を、アルカリ 触媒の存在下に、加水分解、縮合してなる加水分解縮合 物(加水分解物および/またはその縮合物)〕、ならび に(B)成分〔化合物(1), (2)および(3)の群 から選ばれた少なくとも1種を、酸触媒の存在下に、加 水分解、縮合してなる加水分解縮合物(加水分解物およ - び/またはその縮合物)〕を用いた、ポリオルガノシロ キサン系の膜形成用組成物である。この本発明の組成物 を、浸漬またはスピンコート法などにより、シリコンウ エハなどの基材に塗布し、加熱により、(A)~(B) 成分の熱重縮合を行なうと、(A)~(B)成分がガラ ス質または巨大高分子の膜を形成し、得られる膜は、低 比誘電率で、かつ高弾性率のため機械的強度に優れ、層 間絶縁膜材料を形成することができる。

【0006】ここで、本発明において、加水分解とは、上記(A)~(B)成分を構成する化合物(1)~(3)中のR¹O-,R²O-基,R⁴O-基およびR⁵O-基が水と反応してシラノール基を生成することである。また、本発明において、縮合とは、(A)~(B)成分を構成する化合物(1)~(3)の加水分解

物のシラノール基が縮合してSi-〇-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも生成することを包含した概念である。

【0007】(A)加水分解縮合物

(A)加水分解縮合物は、上記化合物(1)~(3)の 群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物をアルカリ触媒の存在下に、加水分解・縮合して得られる。以 下、化合物(1)~(3)、アルカリ触媒について説明 する。

化合物(1):上記一般式(1)において、RおよびR1の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリーnープロポキシシラン、トリーisoープロポキシシラン、トリーnーブトキシシラン、トリーsecーブトキシシラン、トリーtertーブトキシシラン、フルオロトリーnープロポキシシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、フルオロトリーsecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブトキシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど;

 $\{0009\}$ メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシラン、メチルトリーi so -プロポキシシラン、メチルトリーn-ブトキシシラン、メチルトリーs e c - ブトキシシラン、メチルトリーs e c - ブトキシシラン、メチルトリーs e c - ブトキシシラン、エチルトリストキシシラン、エチルトリーn-プロポキシシラン、エチルトリーn-プロポキシシラン、エチルトリーn-プトキシシラン、エチルトリーn-プトキシシラン、エチルトリーn-プトキシシラン、エチルトリーn-プトキシシラン、ビニルトリストキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルトリーn-

ン、ビニルトリーn-ブトキシシラン、ビニルトリーs ec-ブトキシシラン、ビニルトリーtert-ブトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピル トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プロピル トリーn-ブトキシシラン、n-プロピルトリーsec ーブトキシシラン、nープロピルトリーtertーブト キシシラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、i-プロピルトリーn-プロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、iープロピルトリー sec-ブトキシシラン、i-プロピルトリーtert ーブトキシシラン、i-プロピルトリフェノキシシラ ン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチルトリエ トキシシラン、n-ブチルトリーn-プロポキシシラ ン、nーブチルトリーisoープロポキシシラン、nー ブチルトリーnーブトキシシラン、nーブチルトリーs ecーブトキシシラン、nーブチルトリーtertーブ トキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラン、se cーブチルトリメトキシシラン、secーブチルトリエ トキシシラン、secーブチルートリーnープロポキシ シラン、secーブチルートリーisoープロポキシシ ラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラン、s ecーブチルートリーsecーブトキシシラン、sec ーブチルートリーtertーブトキシシラン、sec-ブチルートリフェノキシシラン、t-ブチルトリメトキ シシラン、セーブチルトリエトキシシラン、セーブチル トリーn-プロポキシシラン、t-ブチルトリーiso ープロポキシシラン、t-ブチルトリーn-ブトキシシ ラン、 t ーブチルトリーsecーブトキシシラン、tー ブチルトリーtert-ブトキシシラン、t-ブチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポ キシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラ -ン、フェニルトリー・nーブトキシシラン、フェニルトリ -sec-ブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ア アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、アートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、 γ -トリフロロプロピルトリエトキシシランなど; 【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecーブト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ

ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージー i soープロポキ シシラン、ジエチルージーnープトキシシラン、ジエチ ルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーnープロピルージーisoープロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertーブトキシシラン、ジ -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピルジエ トキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーisoープロピルージーnーブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーsecーブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtertーブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ・ ラン、ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーnーブチ ルジエトキシシラン、ジーn-ブチルージーn-プロポ キシシラン、ジーnーブチルージーisoープロポキシ シラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーn-ブチルージーtertーブトキシシラン、ジーnーブチ ルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチルジメト キシシラン、ジーsec - ブチルジエトキシシラン、ジ -sec-ブチルージーn-プロポキシシラン、ジーs e c - ブチルージーiso-プロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsecーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーtertーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジ メトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーnープロポキシシラ -シ、ジーtert-ブチルージーiso-プロポキシシ ラン、ジーtert-ブチルージーn-ブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーsecーブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシシ ラン、ジーtert-ブチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル ージーnーブトキシシラン、ジフェニルージーsec-ブトキシシラン、ジフェニルージーtert-ブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。

【0011】好ましくは、メチルトリメトキシシラン、 メチルトリエトキシシラン、メチルトリーnープロポキ シシラン、メチルトリーiso一プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)において、1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一般式(2)で表される化合物の具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、テトラーnーブトキシラン、テトラーsecーブトキシシラン、テトラーもertーブトキシシラン、テトラフェノキシシランなどが挙げられる。

【0013】化合物(3);上記一般式(3)におい て、1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な 有機基を挙げることができる。一般式(3)のうち、R 7 が酸素原子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロ キサン、ヘキサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキ シジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ -3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペン タエトキシー3-メチルジシロキサン、1,1,1, 3,3-ペンタフェノキシ-3-メチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-エチルジシ ロキサン、1,1,1,3,3-ペンタエトキシ-3-エチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェ ノキシー3-エチルジシロキサン、1,1,1,3,3 ーペンタメトキシー3-フェニルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ-3-フェニルジシロ キサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-フェニルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキ シ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3ージメチルジシロキサン、1, 1,3,3-テトラフェノキシー1,3-ジメチルジシ ロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキ シー1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1,3-ジエチルジシロキサン、 1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジフェニル ジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシー1. 3-ジフェニルジシロキサン、1,1,3,3-テトラ フェノキシー1, 3ージフェニルジシロキサン、1, 1,3-トリメトキシ-1,3,3-トリメチルジシロ キサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-トリ メチルジシロキサン、1,1,3-トリフェノキシー 1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-ト

リメトキシー1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、 1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-トリエチルジ シロキサン、1,1,3-トリフェノキシー1,3,3 ートリエチルジシロキサン、1、1、3ートリメトキシ -1, 3, 3-ートリエトキシー1、3、3ートリフェニルジシロキサ ェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシー1,1,3,3-テトラメチルジシ ロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3,3-テト ラエチルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1,1, 3,3-テトラエチルジシロキサン、1,3-ジフェノ キシー1,1,3,3ーテトラエチルジシロキサン、 1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニル ジシロキサン、1,3-ジエトキシ-1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジフェノキシー 1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを挙 げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3-ジメトキシー1,1,3-ジメトキシー1,1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2, 2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-メチルジシラ λ , 1, 1, 1, 2, 2- λ ルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタメトキシー2 ーエチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1、1、1、2、2-ペンタ フェノキシー2ーエチルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタメトキシー2ーフェニルジシラン、1,1, 1,2,2-ペンタエトキシ-2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2ーペンタフェノキシー2ーフェニル ジシラン、1,1,2,2-テトラメトキシー1,2-ジメチルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2,2 ーテトラメトキシー1,2-ジエチルジシラン、1,

1.2.2-テトラエトキシー1,2-ジエチルジシラ $\nu, 1, 1, 2, 2-rhjjz_1/4 = 1, 2-ix$ チルジシラン、1,1,2,2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1,1,2,2-テトラエト キシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリメチルジシラ ν , 1, 1, 2-hyrh+ ν -1, 2, 2-hyx+ ルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2 ートリメチルジシラン、1,1,2ートリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、1, 1, 2-トリエ トキシー1.2.2ートリエチルジシラン、1.1.2 -トリフェノキシー1,2,2-トリエチルジシラン、 1.1.2-トリメトキシー1,2,2-トリフェニル ジシラン、1,1,2-トリエトキシ-1,2,2-ト リフェニルジシラン、1,1,2-トリフェノキシー 1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2-ジメトキ シ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチルジシラン、 1, 2-37 1, 1, 2, 2-7 1, 1, 2, 2-7ジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1,2,2-テト ラエチルジシラン、1,2-ジエトキシー1,1,2, 2-テトラエチルジシラン、1,2-ジフェノキシー 1, 1, 2, 2ーテトラエチルジシラン、1, 2ージメ トキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラン、 1, 2-ジェトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニル ジシラン、1,2-ジフェノキシ-1,1,2,2-テ トラフェニルジシランなどを挙げることができる。 【0016】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2-テトラメト キシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テ トラエトキシー1, 2*ージメチルジ*シラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラ ν , 1, 2- ν ×h+ ν -1, 1, 2, 2- τ h- ν ×h- ν ルジシラン、1, 2-ジェトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジエトキシ -1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、好 ましい例として挙げることができる。 【0017】さらに、一般式(3)において、R⁷が-(CH。)。-で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス (トリエトキシシ リル) メタン、ビス (トリーnープロポキシシリル) メ タン、ビス (トリーi-プロポキシシリル) メタン、ビ ス (トリーnーブトキシシリル) メタン、ビス (トリー sec-ブトキシシリル) メタン、ビス (トリーt-ブ トキシシリル) メタン、1,2-ビス(トリメトキシシ リル) エタン、1,2-ピス(トリエトキシシリル) エ タン、1,2-ビス(トリーn-プロポキシシリル)エ タン、1,2-ピス(トリーi-プロポキシシリル)エ

タン、1、2-ピス(トリーn-ブトキシシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーセーブトキシシリル)エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル)-1-(トリーn-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ リル)-1-(トリーi-プロポキシシリル)メタン、 1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリー n-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ-sec-ブト キシメチルシリル)-1-(トリーsecーブトキシシ リル) メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1-(トリーセーブトキシシリル)メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ チルシリル)-2-(トリーn-プロポキシシリル)エ タン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-2-(トリーiープロポキシシリル)エタン、1ー(ジーn ープトキシメチルシリル)-2-(トリ-n-ブトキシ シリル) エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシ リル)-2-(トリーsec-ブトキシシリル)エタ ン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(ト リーセーブトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーn-プロポキシメチルシリル) メタ ン、ビス (ジー i - プロポキシメチルシリル) メタン、 ビス (ジー n – ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル)メタン、ビス (ジーtーブトキシメチルシリル)メタン、1,2-ビ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1、2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル)エタン、1,2-ピス (ジーn-ブトキシメチルシリル) エタン、1,2 ービス (ジーsecーブトキシメチルシリル) エタン、 1.2-ビス(ジーtープトキシメチルシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ピス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 2 ービス(トリーnープロポキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1.3-ピス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1,3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、

1、3-ビス(トリーsec - ブトキシシリル)ベンゼン、1、3-ビス(トリーt - ブトキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリーnープロボキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリーi-プロボキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリーnーブトキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリーsecーブトキシシリル)ベンゼン、1、4-ビス(トリーsecーブトキシシリル)ベンゼンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、 ビス (トリメトキシシリ ル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) エタン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジメトキシメチ ルシリル) -1- (トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリ ル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチ ルシリル) -2-(トリエトキシシリル) エタン、ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシ メチルシリル) メタン、1,2-ビス(ジメトキシメチ ルシリル) エタン、1,2-ビス (ジエトキシメチルシ リル) エタン、1,2-ビス(トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1,2~ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1,3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,4 ービス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1,4ービス (トリエトキシシリル)ベンゼンなどを好ましい例とし て挙げることができる。

【0019】本発明において、(A)成分を構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物(1),(2)および(3)の1種もしくは2種以上を用いることができる。

【0020】なお、上記(A)成分を構成する化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、R¹〇-基、R²〇-基、R¹〇-基およびR⁵〇-基の総量1モル当たり、5~50モルの水を用いることが好ましく、7~30モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が5モルより少ない場合は、十分な比誘電率と弾性率が得られない場合があり、一方、50モルより多い場合は、加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じる場合がある。

【0021】アルカリ触媒:本発明の(A)加水分解縮合物を製造するに際しては、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、アルカリ触媒を用いる。アルカリ触媒としては、無機塩基のほか、有機塩基などが挙げられる。ここで、無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウ

ム、水酸化カルシウムなどを挙げることができる。ま た、有機塩基としては、例えば、メタノールアミン、エ タノールアミン、プロパノールアミン、ブタノールアミ ン、N-メチルメタノールアミン、N-エチルメタノー ルアミン、N-プロピルメタノールアミン、N-ブチル メタノールアミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、N-プロピルエタノールアミ ン、N-ブチルエタノールアミン、N-メチルプロパノ ールアミン、N-エチルプロパノールアミン、N-プロ ピルプロパノールアミン、N-ブチルプロパノールアミ ン、N-メチルブタノールアミン、N-エチルブタノー ルアミン、Nープロピルブタノールアミン、Nーブチル ブタノールアミン、N, N-ジメチルメタノールアミ ン、N, N-ジエチルメタノールアミン、N, N-ジプ ロピルメタノールアミン、N, N-ジブチルメタノール アミン、N, N-ジメチルエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、N、N-ジプロピルエタノ ールアミン、N,N-ジブチルエタノールアミン、N. N-ジメチルプロパノールアミン、N, N-ジエチルプ ロパノールアミン、N, N-ジプロピルプロパノールア ミン、N, N-ジブチルプロパノールアミン、N, N-ジメチルブタノールアミン、N, N-ジエチルブタノー ルアミン、N, N-ジプロピルブタノールアミン、N, N-ジブチルブタノールアミン、N-メチルジメタノー ルアミン、N-エチルジメタノールアミン、N-プロピ ルジメタノールアミン、N-ブチルジメタノールアミ ン、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタ ノールアミン、Nープロピルジエタノールアミン、N-ブチルジエタノールアミン、N-メチルジプロパノール アミン、N-エチルジプロパノールアミン、N-プロピ ルジプロパノールアミン、N-ブチルジプロパノールア ミン、N-メチルジブタノールアミン、N-エチルジブ タノールアミン、N-プロピルジブタノールアミン、N ーブチルジブタノールアミン、N-(アミノメチル)メ タノールアミン、N-(アミノメチル)エタノールアミ ン、N-(アミノメチル)プロパノールアミン、N-(アミノメチル) ブタノールアミン、N-(アミノエチ ル) メタノールアミン、N-(アミノエチル) エタノー ルアミン、N-(アミノエチル)プロパノールアミン、 N-(アミノエチル)ブタノールアミン、N-(アミノ プロピル)メタノールアミン、N-(アミノプロピル) エタノールアミン、N-(アミノプロビル)プロパノー ルアミン、N-(アミノプロピル)ブタノールアミン、 N-(アミノブチル)メタノールアミン、N-(アミノ ブチル) エタノールアミン、N-(アミノブチル) プロ パノールアミン、N-(アミノブチル)ブタノールアミ ン、メトキシメチルアミン、メトキシエチルアミン、メ トキシプロピルアミン、メトキシブチルアミン、エトキ シメチルアミン、エトキシエチルアミン、エトキシプロ ピルアミン、エトキシブチルアミン、プロポキシメチル

アミン、プロポキシエチルアミン、プロポキシプロピル アミン、プロポキシブチルアミン、ブトキシメチルアミ ン、ブトキシエチルアミン、ブトキシプロピルアミン、 ブトキシブチルアミン、メチルアミン、エチルアミン、 プロピルアミン、ブチルアミン、N, N-ジメチルアミ ン、N, N-ジエチルアミン、N, N-ジプロピルアミ ン、N、N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリ エチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミ ン、テトラメチルアンモニウムハイドロキサイド、テト ラエチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラプロピ ルアンモニウムハイドロキサイド、テトラブチルアンモ ニウムハイドロキサイド、テトラメチルエチレンジアミ ン、テトラエチルエチレンジアミン、テトラプロピルエ チレンジアミン、テトラブチルエチレンジアミン、メチ ルアミノメチルアミン、メチルアミノエチルアミン、メ チルアミノプロピルアミン、メチルアミノブチルアミ ン、エチルアミノメチルアミン、エチルアミノエチルア ミン、エチルアミノプロピルアミン、エチルアミノブチ ルアミン、プロピルアミノメチルアミン、プロピルアミ ノエチルアミン、プロピルアミノプロピルアミン、プロ ピルアミノブチルアミン、ブチルアミノメチルアミン、 ブチルアミノエチルアミン、ブチルアミノプロピルアミ ン、ブチルアミノブチルアミン、ピリジン、ピロール、 ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリン、モル ホリン、メチルモルホリン、ジアザビシクロオクラン、 ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、水 酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルア ンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、水酸 化テトラブチルアンモニウムなどを挙げることができ る。これらのアルカリ触媒は、1種あるいは2種以上を 同時に使用してもよい。

【0022】上記アルカリ触媒の使用量は、化合物 (1)~(3)中のR¹O-基,R²O-基,R⁴O-基およびR⁵O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、0.00001~0.5モル、好ましくは0.0005~0.5モルである。アルカリ触媒の使用量が上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。

【0023】このようにして得られる(A)加水分解縮合物の分子量は、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)法による重量平均分子量で、好ましくは5万~1,000万、さらに好ましくは10万~900万、特に好ましくは20万~800万である。5万未満では、十分な比誘電率と弾性率が得られない場合があり、一方、1,000万より大きい場合は、塗膜の均一性が低下する場合がある。また、このようにして得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形態をとっていないことにより、基板状への塗布性が優れるという特徴を有している。粒子状の形態をとっていないことは、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認される。

【0024】なお、(A)成分中、各成分を完全加水分 解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、化合物 (1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ましくは 10~70重量%、さらに好ましくは15~70重量% である。また、化合物(1)および/または(3)は、 化合物(1)~(3)の総量中、95~25重量%、好 ましくは90~30重量%、さらに好ましくは85~3 0重量%である。化合物(2)が、化合物(1)~ (3)の総量中、5~75重量%であることが、得られ る塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に優れる。こ こで、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合 物(1)~(3)中のR¹ O-基, R² O-基, R⁴ O -基およびR⁵ O-基が100%加水分解してSiOH 基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構造となっ たものをいう。また、(A)成分としては、得られる組 成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物(1)およ び化合物(2)の加水分解縮合物であることが好まし

【0025】さらに、(A)加水分解縮合物では、化合 物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシ ラン化合物を、アルカリ触媒の存在下に加水分解・縮合 して、加水分解縮合物とし、好ましくはその重量平均分 子量を5万~1,000万となすが、その後、組成物の pHを7以下に調整することが好ましい。pHを調整す る方法としては、(1)pH調整剤を添加する方法、 (2) 常圧または減圧下で、組成物中よりアルカリ触媒 を留去する方法、(3)窒素、アルゴンなどのガスをバ ブリングすることにより、組成物中からアルカリ触媒を 除去する方法、(4)イオン交換樹脂により、組成物中 からアルカリ触媒を除く方法、などが挙げられる。これ らの方法は、それぞれ、組み合わせて用いてもよい。 【0026】ここで、上記pH調整剤としては、無機酸 や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩 酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸な どを挙げることができる。また、有機酸としては、例え ば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキ サン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン 酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ ドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンス ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、コハク酸などを挙げることができる。な お、上記の酸を触媒として合成された後述する(B)加 水分解縮合物をブレンドすることもできる。

【0027】上記pH調整剤による組成物opHは、7以下、好ましくは $1\sim6$ に調整される。このように、加

水分解縮合物の重量平均分子量を5万~1,000万となしたのち、上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整することにより、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpHが上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択される。

【0028】(B)加水分解縮合物

(B)加水分解縮合物は、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を酸触媒の存在下に、加水分解・縮合して得られる。ここで、化合物(1)~(3)の種類や加水分解・縮合に用いられる水の量は、(A)加水分解縮合物に用いられるシラン化合物や水の量と同様であるので、省略する。なお、上記(B)成分を構成する化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、R¹〇一基,R²〇一基,R¹〇一基およびR⁵〇一基の総量1モルあたり、〇.25~5モルの水を用いることが好ましく、〇.3~3モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が〇.25~5モルの範囲内であれば、塗膜の均一性が低下する恐れがなく、また、加水分解および縮合反応中のボリマーの析出やゲル化の恐れも少ないためである。

【0029】酸触媒;本発明の(B)加水分解縮合物を製造するには、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、酸触媒を用いる。ここで、酸触媒の種類としては、上記(A)加水分解縮合物の調製の際に用いられることのあるpH調整剤である無機酸や有機酸と同様であるので、その説明は省略する。なお、酸触媒としては、有機酸が好ましい。

【0030】上記酸触媒の使用量も、化合物(1)~(3)中のR¹ O-基, R² O-基, R⁴ O-基および R⁵ O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、0.00001~0.5モル、好ましくは0.0005~0.1モルである。酸触媒の使用量が上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少な

【0031】このようにして得られる(B)加水分解縮合物の分子量は、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)法による重量平均分子量で、好ましくは500~30万、さらに好ましくは700~20万、特に好ましくは1,000~10万である。500未満では、塗膜の均一性が低下する場合があり、一方、30万より大きい場合は、貯蔵安定性が得られない場合がある。また、このようにして得られる(B)加水分解縮合物も、粒子状の形態をとっていないことにより、基板状への塗布性が優れるという特徴を有している。粒子状の形態をとっていないことは、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認される。

【0032】(A)成分と(B)成分の割合

本発明の膜形成用組成物は、上記(A)~(B)成分を含有するが、両者の割合は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100重量部に対し、(B)(完全加水分解縮合物換算)が好ましくは1~900重量部、さらに好ましくは3~800重量部、特に好ましくは5~800重量部である。(B)成分が1重量部未満では、得られる塗膜の機械的強度が充分でない場合があり、一方、900重量部を超えると、充分な低比誘電率が得られない場合がある。

【0033】(C)溶媒

本発明の膜形成用組成物は、(A)加水分解縮合物と(B)加水分解縮合物とを、(C)溶媒に溶解または分散してなる。この(C)溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒およびエステル系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。

【0034】ここで、アルコール系溶媒としては、メタ ノール、エタノール、nープロパノール、iープロパノ ール、nーブタノール、iーブタノール、secーブタ ノール、tーブタノール、nーペンタノール、iーペン タノール、2-メチルブタノール、5 e c - ペンタノー ル、tーペンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキ サノール、2-エチルブタノール、5 e c - ヘプタノー ル、ヘプタノール-3、n-オクタノール、2-エチル ヘキサノール、sec-オクタノール、n-ノニルアル コール、2,6ージメチルヘプタノールー4、nーデカ ノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノ ニルアルコール、sec-テトラデシルアルコール、s ecーヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘ キサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒; 【0035】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1、3ープチレングリコール、ペンタンジ オール-2,4、2-メチルペンタンジオール-2, 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることができる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0036】これらアルコールのうち、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、i-ブタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベンタノール、n-ベキサノール、n-ベキサノール、n-ベキサノール、n-ベール、n-ベール・n-ベール

【0037】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー nーブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiーブチ ルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnー ブチルケトン、メチルーnーヘキシルケトン、ジーi-ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2, 4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5 -ヘプタンジオン、2,4-オクタンジオン、3,5-オクタンジオン、2,4-ノナンジオン、3,5-ノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2, 1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ヘ プタンジオンなどのβ-ジケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 _に使用してもよい。_

【0038】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、Nーエチルホルムアミド、Nーンメチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージエチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージエチルピロリドン、Nーホルミルピロリジン、Nーホルミルピロリジン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これらアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0039】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ

ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、アーブチロラクトン、ア ーバレロラクトン、酢酸n-プロピル、酢酸i-プロピ ル、酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブ チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー nーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、シ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸 n - ブチル、プロピオン酸 i - アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。以上の (C)溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用す ることができる。

【0040】本発明の膜形成用組成物は、上記の(C)溶媒を含有するが、(A)~(B)成分を構成する化合物(1)~(3)を加水分解および/または縮合する際に、同様の溶媒を使用することができる。

【0041】具体的には、水およびアルカリ触媒(あるいは酸触媒)を添加した上記(C)溶媒中に、化合物(1)~(3)の少なくとも1種を一括または断続的あるいは連続的に添加したのち、さらに加水分解および縮合反応を行う。この際の反応温度としては、通常、0~100℃、好ましくは15~90℃である。

【0042】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらに界面活性 剤などの成分を添加してもよい。界面活性剤としては、 例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性 剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げ られ、さらには、シリコーン系界面活性剤、ボリアルキ レンオキシド系界面活性剤、含フッ素界面活性剤などを 挙げることができる。なお、本発明の組成物中には、塗 膜を均一にするために、シリカ粒子が含まれていないこ とが望ましい。

【0043】組成物の調製方法

本発明の組成物を調製するに際しては、例えば、水とア

ルカリ触媒(または酸触媒)を添加した(C)溶媒中に、化合物(1)~(3)の少なくとも1種(以下「シラン化合物」ともいう)を一括または断続的もしくは連続的に添加して、通常、0~100℃、好ましくは15~90℃で1~12時間撹拌し、加水分解および縮合反応を行う。調製の各段階において、濃縮または(C)溶媒添加による希釈を行うことで任意の濃度に調整できる。

【 0 0 4 4 】 本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記(1)~(12)の方法などにより、(A)成分あるいは(B)成分を調製し、次いで、得られた(A)~(B)成分をブレンドすればよい。

- (1)水、アルカリ触媒(または酸触媒)および(C)溶媒からなる混合物に、所定量のシラン化合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- (2) 水、アルカリ触媒(または酸触媒)および(C)溶媒からなる混合物に、所定量のシラン化合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- (3) 所定のシラン化合物および(C)溶媒からなる混合物に、水、アルカリ触媒(または酸触媒)および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- (4) 所定のシラン化合物および(C)溶媒からなる混合物に、水、アルカリ触媒(または酸触媒)および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- 【 O O 4 5 】 (5) 所定のシラン化合物、アルカリ触媒(または酸触媒) および(C) 溶媒からなる混合物に、水および必要に応じて(C) 溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A) 加水分解縮合物(または(B) 加水分解縮合物)を得る。
- (6) 所定のシラン化合物、アルカリ触媒(または酸触媒)および(C)溶媒からなる混合物に、水および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- (7) 所定量の水および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物に、所定量のシラン化合物、アルカリ触媒(または酸触媒)および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。
- (8) 所定量の水および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物に、所定量のシラン化合物、アルカリ触媒(ま

たは酸触媒) および必要に応じて (C) 溶媒からなる混合物を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。

【0046】(9)所定量の水、シラン化合物および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物に、所定量のアルカリ触媒(または酸触媒)および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。

- (10) 所定量の水、シラン化合物および必要に応じて (C) 溶媒からなる混合物に、所定量のアルカリ触媒 (または酸触媒) および必要に応じて(C) 溶媒からな る混合物を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分 解・縮合反応を行ない、(A) 加水分解縮合物〔または (B) 加水分解縮合物〕を得る。
- (11) 所定量のアルカリ触媒(または酸触媒) および必要に応じて(C) 溶媒からなる混合物に、所定量の水、シラン化合物および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を加えて、加水分解・縮合反応を行ない、
- (A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕 を得る。
- (12) 所定量のアルカリ触媒(または酸触媒)および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物に、所定量の水、シラン化合物および必要に応じて(C)溶媒からなる混合物を、連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行ない、(A)加水分解縮合物〔または(B)加水分解縮合物〕を得る。なお、本発明において、シラン化合物を加水分解・縮合する際の反応液の固形分濃度は、通常、0.1~50重量%である。

【0047】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~50重量%、好ましくは2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~50重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記(C)溶媒による希釈によって行われる。

【0048】このようにして得られる本発明の組成物は、必要に応じて、フィルターでろ過したのち、使用することができる。フィルターは、ポリエステル、ポリカーボネート、セルロース、セルロースアセテート、ボリプロピレン、ポリエーテルサルホン、四フッ化エチレン(PTFE)、ポリアミドなどの材質のものを使用することができる。好ましくは、孔径0.2μm以下のPTFE製フィルター、特に好ましくは、孔径0.05μm以下のPTFE製フィルターを用いることが、組成物中の異物を除去し、得られる塗膜の均一性が優れる点で好ましい。上記のようなフィルターは、材質や孔径の異なるものを組み合わせて使用することができ、また、同一

材質や孔径の異なるものを、複数個組み合わせて使用することもできる。

【0049】本発明の組成物を用いて膜を形成するには、まず本発明の組成物を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物を塗布することができる基板としては、半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられる。また、塗布方法としては、スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物は、特にシリコンウエハ、SiO2ウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。

【0050】この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行なうことができる。ここで、加熱処理条件は、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下もしくは酸素濃度100ppm以下にコントロールした減圧下で、450℃以下の温度で処理することが好ましい。また、上記の

(A)成分の硬化速度を制御するため、必要に応じて、 段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧などの雰 囲気を選択することができる。

【0051】このようにして得られる本発明の膜の比誘電率は、低比誘電率であり、通常、 $2.7\sim1.5$ 、好ましくは $2.6\sim1.5$ 、さらに好ましくは $2.5\sim1.5$ である。

【0052】また、本発明の膜は、高弾性率を有し、ヤング率が、通常、3~10GPa、好ましくは4~10GPaである。この弾性率は、本発明に記載の方法で調製した(A)~(B)成分の加水分解縮合物を本発明記載の方法で焼成することにより得られる。

【0053】さらに、本発明の膜は、膜密度が、通常、0.5~1.4g/cm³、好ましくは0.5~1.3g/cm³、さらに好ましくは0.5~1.2g/cm³である。膜密度が0.5g/cm³未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.4g/cm³を超えると、低比誘電率が得られない。

【0054】さらに、本発明の膜は、吸水性が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2.5atm、100%RHの環境に1時間放置した場合、放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の吸着は認められない。この低吸水性は、例えば、本発明における膜形成用組成物中の化合物(2)の含有量を本発明に記載の範囲とすることにより得ることができる。

【0055】本発明の膜は、絶縁性に優れ、高弾性率であり、さらに塗布膜の均一性、比誘電率特性、塗膜の耐クラック性、塗膜の表面硬度に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の

層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用 途に有用である。また、本発明の絶縁膜を有する半導体 装置は、金属配線間に本発明の膜を絶縁膜として有する ものである。

[0056]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、各種の評価は、次のようにして行なった。

【0057】重量平均分子量

下記条件によるゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC)(屈折率,粘度,光散乱測定)法により測定した。試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメタノールで希釈し、GPC(屈折率,粘度,光散乱測定)用試料溶液とした。

装置: 東ソー (株) 製、GPCシステム モデル GP C-8020

東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/300 n

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液:10mMのLiBrを含むメタノール キャリア送液速度:1ml/min

カラム温度:40℃

【0058】貯蔵安定性

本発明の組成物80mlを容量100mlのガラス製ね じ口瓶に入れて密閉し、40℃オートクレーブ中で1ヶ 月放置した。放置前後のサンプルを2,500rpm、 31秒のスピンコート条件で塗布し、実施例の方法で焼成したときの膜厚を光学式膜厚計(Rudolph Technologies社製、Spectra Laser200)にて測定し、その変化率(〔(放置後のサンブルの膜厚ー放置前のサンプルの膜厚)/放置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が置前のサンブルの膜厚)が正式を

◎:膜厚変化率< 5%

○: 膜厚変化率<10%

×: 膜厚変化率≥10%

【0059】比誘電率

得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

膜密度

密度は、膜の膜厚と膜の面積から求めた体積と、膜の重量から算出した。

弾性率(ヤング率)

得られた膜を、ナノインデンターXP(MST社製)を 用いて、連続剛性測定法により測定した。

【0060】吸水性

得られた塗膜を127℃、2.5atm、100%R H、の環境に1時間放置し、放置後の塗膜のIRスペクトルを観察した。放置前の塗膜のIRスペクトルと比較して、3,500cm⁻¹付近のH₂ Oに起因する吸収の有無を観察し、吸水性を下記基準に従い評価した。

〇:吸収無し

×:吸収有り

【0061】参考例1〔(A-1)成分の調製〕 25%アンモニア水溶液5g、超純水320gおよびエタノール600gの混合溶液中にメチルトリメトキシシラン15g(完全加水分解縮合物換算7.4g)とテトラエトキシシラン20g(完全加水分解縮合物換算5.8g)を加え60℃で3時間反応をさせたのち、プロピレングリコールモノプロピルエーテル200gを加え、その後、減圧下で全溶液量200gとなるまで濃縮し、固形分含有量6.6%の(A-1)成分組成物溶液を得た。得られた(A-1)成分の重量平均分子量は、30万であった。

【0062】参考例2〔(A-1)成分の調製〕 参考例1記載の(A-1)成分溶液200gをさらに全容液量140gとなるまで濃縮し、その後、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、固形分含有量8.8%の組成物溶液を得た。得られた(A)成分の重量平均分子量は、30万であった。また、電導度滴定により求めた残留シラノールのカウント数は、酢酸添加前後で変化が認められなかった。

【0063】参考例3〔(B)成分の調製〕

テトラメトキシシラン101.3g(完全加水分解縮合物換算;40.0g)、メチルトリメトキシシラン203.0g(完全加水分解縮合物換算;100.0g)、ジメチルジメトキシシラン97.3g(完全加水分解縮合物換算;60.0g)、プロピレングリコールモノプロピルエーテル559.3g、メチルーn-ペンチルケトン239.7gの混合溶液に、マレイン酸1.0g(触媒/SiOR=0.001mol比)を水157.7g(H₂O/SiOR=1.0mol比)に溶かした水溶液を、室温で1時間かけて滴下した。混合物の滴下を了後、さらに60℃で2時間反応させたのち、減圧下で全溶液量1,000gになるまで濃縮し、固形分含有量20%の(B)成分を得た。得られた(B)成分の重量平均分子量は、3,000であった。

【0064】参考例4〔(A-2)成分の調製〕 参考例1において、25%アンモニア水溶液5gの代わ りに25%水酸化テトラメチルアンモニウム0.5gを使用したこと以外は、参考例1と同様にして、重量平均分子量100万の成分の得た。この成分を参考例2と同様に処理を行った。得られた(A-2)成分の重量平均分子量は、100万であった。また、電導度滴定により求めた残留シラノールのカウント数は、酢酸添加前後で変化が認められなかった。

【0065】比較参考例1

超純水320gの代わりに超純水32g、エタノール600gの代わりにエタノール888gを用いた以外は、参考例1と同様の操作を行い、固形分含有量6.6%の組成物溶液を得た。得られた組成物のポリスチレン換算分子量は、4万であった。

【0066】実施例1

参考例1記載の(A-1)成分溶液96.5gと、参考例3記載の(B)成分溶液3.5gを混合し、固形分含有量7.1%の組成物溶液を得た。得られた組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空中で340℃、360℃、380℃の順で、それぞれ、30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。得られた膜の評価結果を表1に示す。

【0067】実施例2

参考例2記載の(A-1)成分溶液84.1gと、参考例3記載の(B)成分溶液15.9gを混合し、固形分含有量10.6%の組成物溶液を得た。得られた組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空中で340℃、360℃、380℃の順で、それぞれ、30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。得られた膜の評価結果を表1に示す。

【0068】実施例3

参考例4記載の(A-2)成分溶液84.1gと、参考例3記載の(B)成分溶液15.9gを混合し、固形分合有量10-6%の組成物溶液を得た。得られた組成物を8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。得られた膜の評価結果を表1に示す。

【0069】比較例1

比較参考例1記載の組成物溶液87.6gと、参考例3記載の(B)成分溶液12.4gを混合し、固形分含有量8.3%の組成物溶液を得た。得られた組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空中で340℃、360

で、380℃の順で、それぞれ、30分間ずつ加熱し、 さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を

【表1】

[0070]

形成した。得られた膜の評価結果を表1に示す。

	1.		1.	<u>-</u>	-		1		- [
1		実施例 1	1 5	実施例2	5	起施例3	1	比較例 1	1
	1.		-		-		1		-
貯蔵安定性	I	0	١	0	1	0	1	0	1
比誘電率	1	2.4	1	2.6	1	2.5	۱.	2.8	I
膜密度(g/cm³)	I	1.2	l	1.3	1	1.3	ı	1.5	1
弾性率(GPa)	ı	5.1	1	6.8	1	7.0	1	7.6	1
吸水性	1	0	l	0	1	0	1	0	1
1] -		۱ -		1 -		ı		-

[0071]

【発明の効果】本発明によれば、得られる膜が低比誘電率かつ高弾性率であり、半導体素子などにおける層間絶

縁膜材料として有用なポリオルガノシロキサン系の膜形 成用組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 徐 榮秀 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 今野 圭二 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 塩田 淳

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J035 BA06 CA01K CA022 CA06K

CA162 EA01 EB03 LA03

LB01

4J038 DL021 DL022 DL031 DL032

DL041 DL042 DL161 DL162

HA096 HA336 HA376 HA416

HA476 JA37 JA38 JB01

JB03 JB04 JB09 JB25 JB39

JC13 KA04 LA03 MA08 MA10

MA14 NA11 NA21 PA19 PB09

PC02 PC03

5F058 AA10 AB07 AC03 AF04 AG01

AHO1 AHO2